

Interscale 柔性散热器 (FHC), 20 mm

物料号

24830-005

导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差，还会优化热路径的表面接触和压力；无需使用导热垫片。



认证



功能

适用于 Intel 产品, AMD, Via, Freescale, 采用 BGA 插座的 NVidia 和 Texas Instrument 处理器

提供行业领先的传导冷却性能, 比当前的传导冷却方法提高 10%

适用于小尺寸电子设备的传导冷却解决方案 (正在申请专利)

用导热胶带固定在 PCB 上

导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差，还会优化热路径的表面接触和压力；无需使用导热垫片

兼容 Interscale C 型机箱

产品属性

产品类型: 导体块

产品系列: Interscale

类型: 热导体

搭配: 仪器箱

包装数量: 1

深度: 22mm

宽度: 22mm

完成: 阳极氧化; 镀锌铝

Gross Weight: 0.074kg

材料: 铝; 钢

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE